

2020年度(2021年3月期) 第2四半期決算概要について



Brightening the Future
Since 1946

2020年度 第2四半期決算概要（連結）

決算概況	2
ICリードフレーム部門	4
ICパッケージ部門	6
気密部品部門	8

2020年度 通期の見通し（連結）

業績予想の修正	10
売上高・損益・配当	11
設備投資額・減価償却費・研究開発費	13

決算概況

（単位：億円）

	2019年度 2Q累計	2020年度 2Q累計	前年同期比		予想比	
				増減率	6/12予想	増減
売上高	693	845	152	22%	828	17
営業利益 （営業利益率）	▲10 （▲1%）	72 （9%）	82	—	67	5
経常利益 （経常利益率）	▲5 （▲1%）	83 （10%）	89	—	67	16
四半期純利益※ （四半期純利益率※）	▲10 （▲1%）	56 （7%）	66	—	43	13

※親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益	▲7.40円	41.25円
-------------	--------	--------

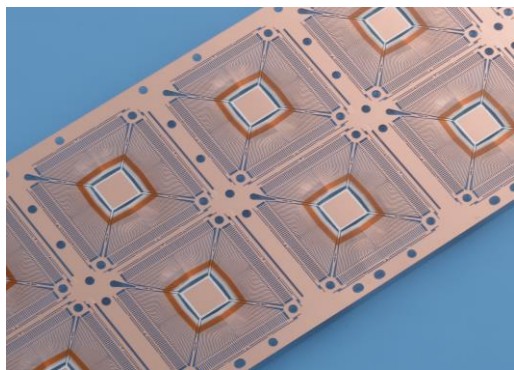
売上高：

- 新型コロナウイルス感染拡大による自動車市場低迷等の影響を受けたものの、テレワーク、オンライン学習の拡大、5Gの実用化などにより、データセンター用サーバー向けやパソコン向けにフリップチップタイプパッケージの売上が大きく拡大し、旺盛な需要を背景に半導体製造装置向けセラミック静電チャックの受注が大幅に増加したことなどにより、前年同期比で22%増加

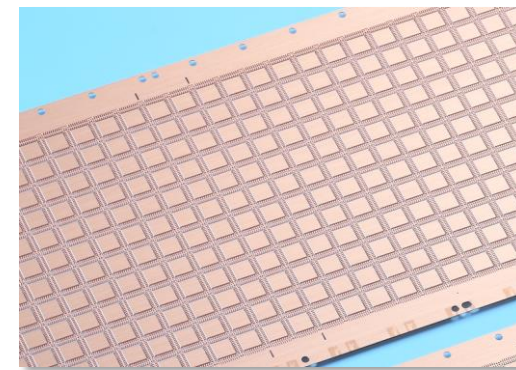
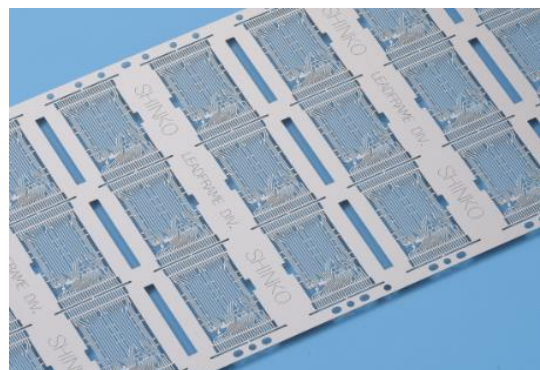
損益：

- 売上増加による収益性の向上や為替差益の計上等により、損益は大幅に好転

ICリードフレーム部門



プレスリードフレーム



エッチングリードフレーム
(QFNタイプ)

【主な搭載製品例】

スマートフォン、自動車、パソコン、家電、産業機器 他

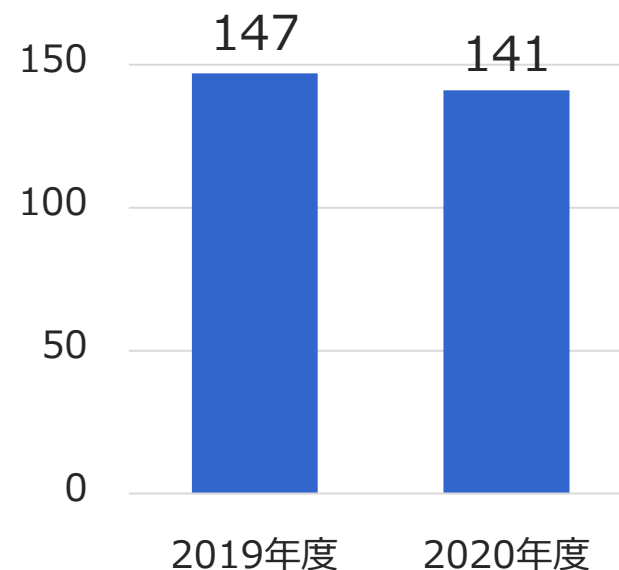
ICリードフレーム部門

(単位：億円)

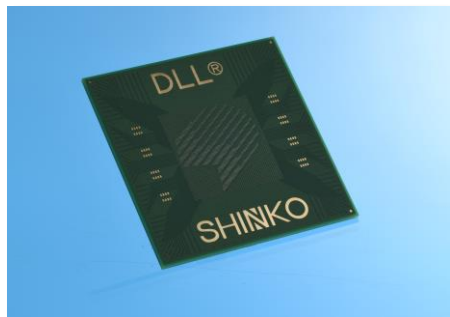
	2019年度 2Q累計	2020年度 2Q累計	前年同期比		2020年 3月期
				増減率	
売上高 (構成比)	147 (21%)	141 (17%)	▲6	▲4%	312

- QFNタイプが幅広い用途向けに需要が増加した一方で、自動車向けおよびメモリー向けの売上が減少

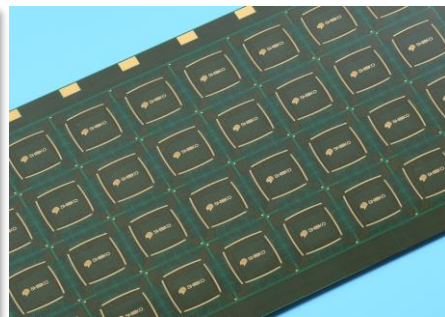
<2Q累計売上高>



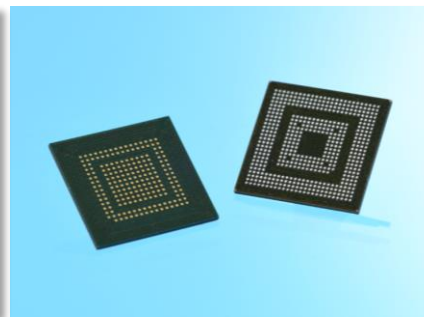
I Cパッケージ部門



フリップチップタイプ
パッケージ



プラスチックBGA基板



I C組立



ヒートスプレッダー

【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他

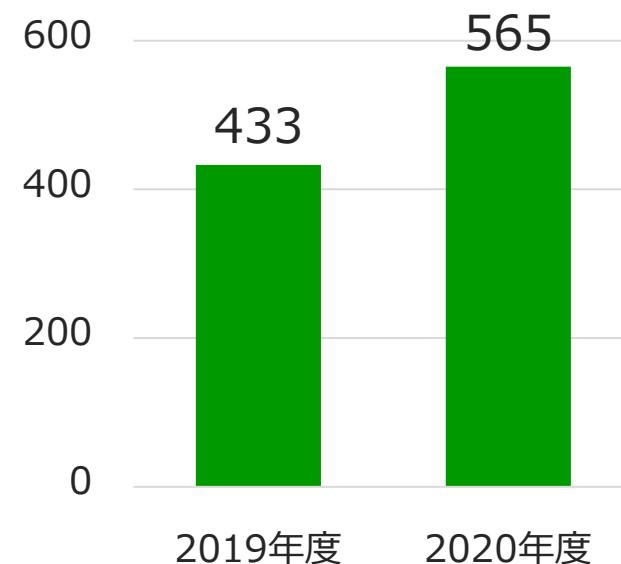
ICパッケージ部門

（単位：億円）

	2019年度 2Q累計	2020年度 2Q累計	前年同期比		2020年 3月期
				増減率	
売上高 (構成比)	433 (63%)	565 (67%)	132	30%	924

- フリップチップタイプパッケージは、サーバー向けおよびパソコン向けに売上が大幅に拡大
- プラスチックBGA基板は、新ラインの稼働開始により先端メモリー向けに受注が大きく増加
- CPU向けヒートスプレッダーは、サーバー向けが好調に推移し、増収
- IC組立は、自動車向けが回復傾向を示し、ハイエンドスマートフォン向けの需要が増加し、増収

<2Q累計売上高>



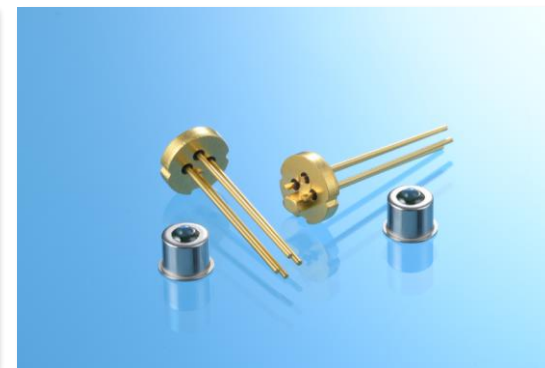
気密部品部門



セラミック静電チャック



光学機器用ガラス端子



光通信用ガラス端子

【主な搭載製品例】

半導体製造装置、自動車、民生機器、通信機器 他

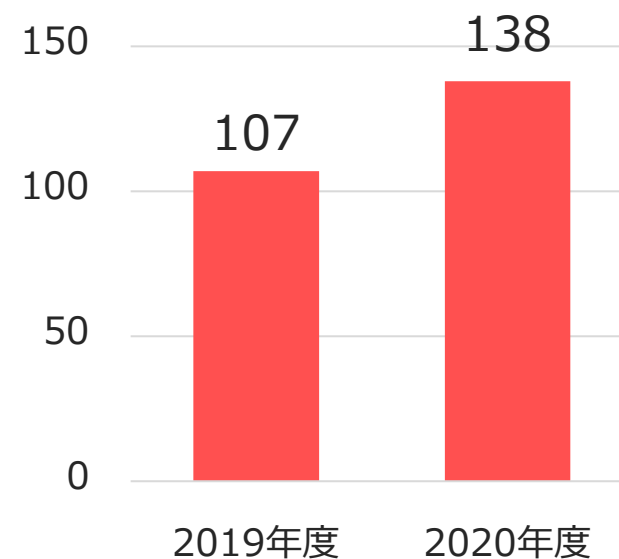
気密部品部門

(単位：億円)

	2019年度 2Q累計	2020年度 2Q累計	前年同期比		2020年 3月期
				増減率	
売上高 (構成比)	107 (15%)	138 (16%)	32	30%	240

- 半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、旺盛な受注環境を背景に売上が大幅に増加
- ガラス端子は、光学機器向け等の受注が低調のまま推移し、減収

< 2 Q累計売上高 >



業績予想の修正（2020/10/27公表）

（単位：億円）

	2020年度通期			
	前回予想 (2020/6/12)	今回予想 (2020/10/27)	前回予想との 増減額	増減比
売上高	1,711	1,773	62	4%
営業利益	107	135	28	26%
経常利益	110	147	37	34%
純利益※	70	100	30	43%
1株当たり当期純利益	51.82円	74.02円	—	—

※親会社株主に帰属する当期純利益

修正理由（要旨）

- テレワーク、オンライン学習の拡大、5G実用化などを背景として、サーバーおよびパソコン向けにフリップチップタイプパッケージの受注が引き続き好調に推移することが予想される。
- 大型の設備投資を展開してきたフリップチップタイプパッケージの生産ラインが、10月度から量産稼働を開始し、今後、順次、生産増加に寄与することが見込まれる。
- セラミック静電チャックは、半導体製造装置市場における旺盛な需要を背景に受注が大きく増加。
- プラスチックBGA基板は、先端メモリー向け新ラインの稼働により売上が拡大。
- これらの増収による収益性の改善等により、特に収益面において想定を上回ることが見込まれることをふまえ、6月12日公表の通期業績予想数値を修正。
- 通期業績予想の前提となる第3四半期以降の為替レートを1米ドル=105円から102円に変更。

売上高・損益・配当

(単位：億円)

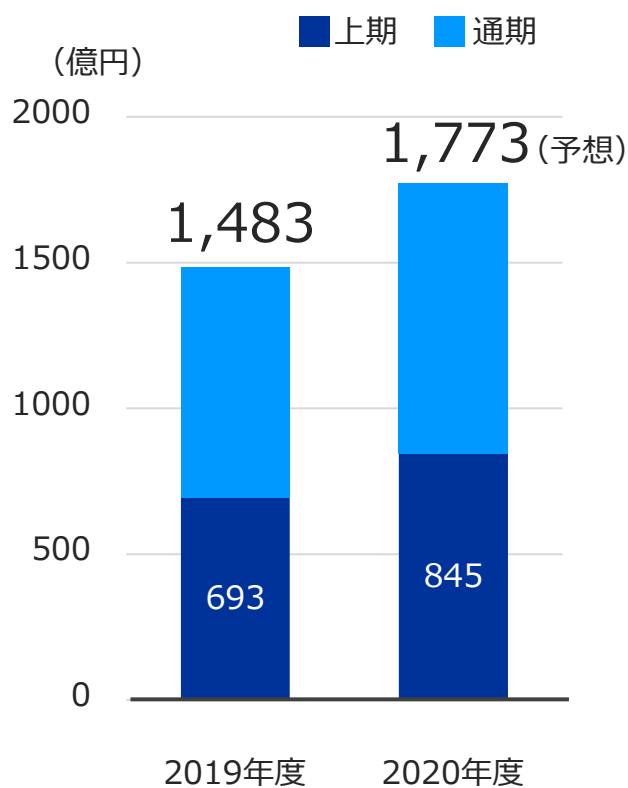
	2019年度 (実績)			2020年度 (上期実績・下期予想)			前年度比	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	通期	増減率
売上高	693	791	1,483	845	928	1,773	290	20%
営業利益 (営業利益率)	▲10 (▲1%)	42 (5%)	32 (2%)	72 (9%)	63 (7%)	135 (8%)	103	318%
経常利益 (経常利益率)	▲5 (▲1%)	53 (7%)	48 (3%)	83 (10%)	64 (7%)	147 (8%)	99	205%
純利益※ (四半期(当期)純利益率※)	▲10 (▲1%)	37 (5%)	27 (2%)	56 (7%)	44 (5%)	100 (6%)	73	272%
為替レート	107円/\$			105円/\$	102円/\$			

※親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

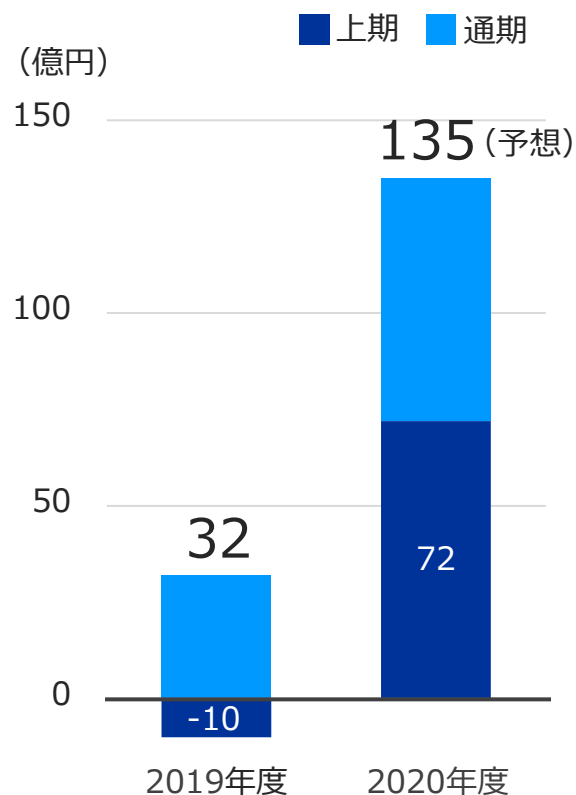
(単位：円)

1株当たり配当金 (配当性向)	12.5 [中間]	12.5 [期末]	25.0 (126%)	12.5 [中間]	12.5 [期末]	25.0 (34%)		
--------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	---------------	--	--

売上高

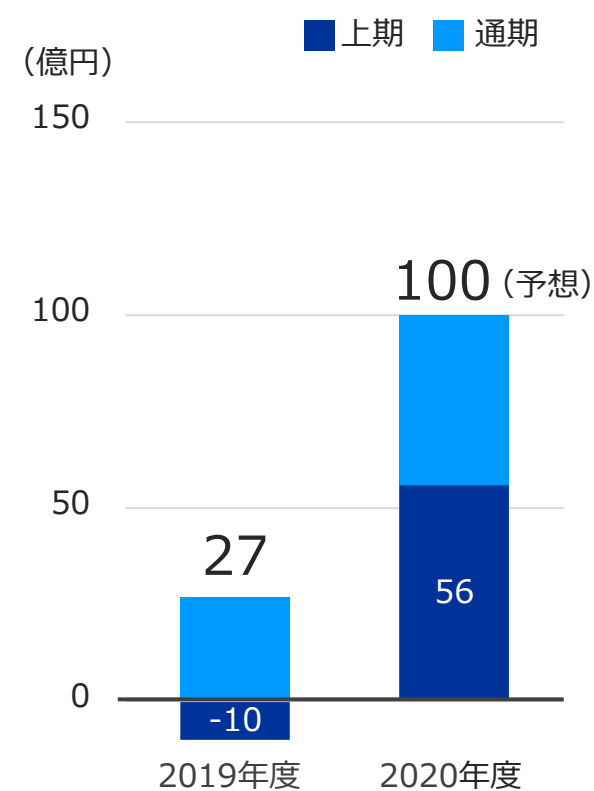


営業利益

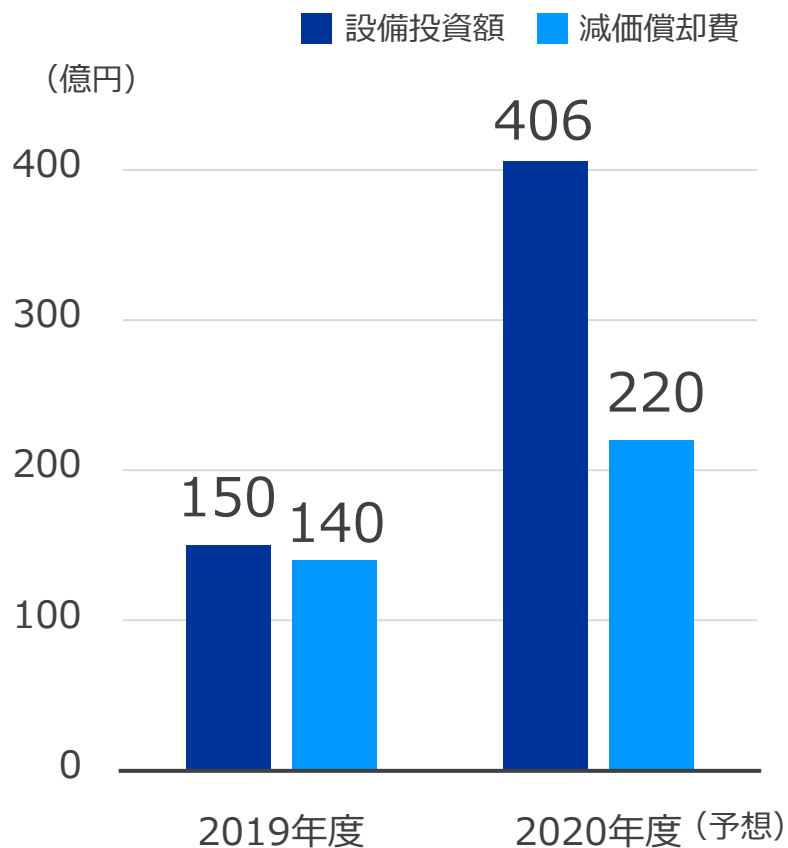


純利益*

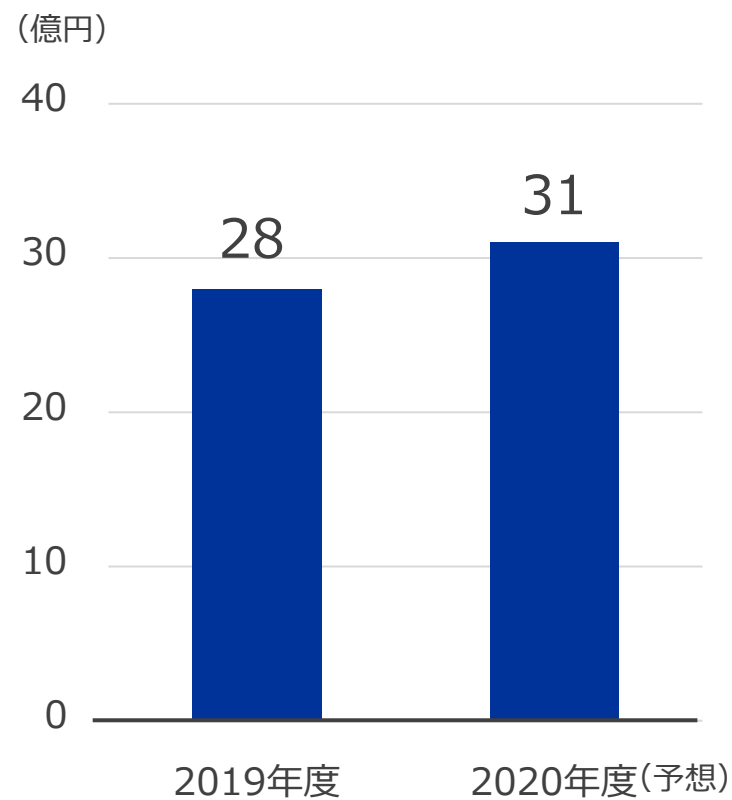
※親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益



設備投資額・減価償却費



研究開発費



本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づくものであり、将来の予想数値の実現を保証するものではありません。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

また、本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信等で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信または四半期報告書を参照していただきますようお願いいたします。